

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Das Basis-Element des modularen CH20M Gehäuses bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für Ihre Projekte machen. Mit speziellen Ausschnitten für Bus- und FE-Kontakte ist es besonders flexibel und anpassungsfähig.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, das Gehäuse mittels Laser zu bedrucken, was Ihnen eine hohe Präzision und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Zudem steht Ihnen eine breite Farbvielfalt zur Verfügung, sodass Sie das Gehäuse ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

Das CH20M Gehäuse ist zudem für Standard-Tragschienen geeignet, was die Installation und Integration in bestehende Systeme erleichtert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschienengehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Seitenelement, Anschlussvorbereitung Micro-SIM-Karte (3FF), Breite: 45 mm
Best.-Nr.	2738670000
Art	CH20M45 B SIM BK/BK 2010
GTIN (EAN)	4064675064091
VPE	6 ST

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	108 mm	Tiefe (inch)	4.252 inch
Höhe	109.3 mm	Höhe (inch)	4.3031 inch
Breite	45 mm	Breite (inch)	1.7716 inch
Nettogewicht	36.53 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-25 °C...85 °C	Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C
Feuchtigkeit	5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PA 66 GF 30
Isolierstoffgruppe	I	Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Tragschiene	TS 35	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011
Vergießbarkeit	Nein		

Baugruppeneigenschaften

Anzahl Steckplätze für Buchsenstecker der assemblierten Gesamtbaugruppe, max.	12	Leiterplattenanzahl, max.	2
Anzahl Anschlussebenen max.	3	Polzahl, max.	48
Höhe der Komponenten auf der Leiterplatte (Verwendung von einer Leiterplatte), max.	38.6 mm	Höhe der Komponenten auf der Leiterplatte (Verwendung von zwei Leiterplatten), max.	34.7 mm
Leiterplattenbestückung	beidseitig		

Mechanische Prüfungen

Entsprechend Norm	DIN EN 61373:1999 (Schock und Vibration)		
Prüfbedingungen	fünf Gehäuse in Reihe montiert, 200g zusätzliches Gewicht pro Leiterkarte, zwei Leiterkarten montiert		
Geprüfte Achsen	X, Y, Z		
Schockprüfung	Allgemeine Testhinweise	Alle mechanischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.	
	Prüfkategorie	1	
	Schockanzahl pro Achse	3 in positiver und negativer Richtung	

CH20M45 B SIM BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Vibrationsprüfung	Schockdauer	30 ms
	Beschleunigung horizontal	30.00 m/s ²
	Beschleunigung vertikal	30.00 m/s ²
	Beschleunigung längsgerichtet	50.00 m/s ²
	Prüfkategorie	1B
	Prüfdauer	5 Stunden pro Achse
	Effektive Beschleunigung	7.9 m/s ²

Thermische Prüfungen

Thermische Prüfungen	Allgemeine Testhinweise	Alle thermischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.	
	Prüfbedingungen	sieben Gehäuse in Reihe montiert - kein Abstand	
	Prüfachsen	horizontal	
	Umgebungstemperatur	55 °C	
	Max. Verlustleistung	4.2 W	
	Umgebungstemperatur	50 °C	
	Max. Verlustleistung	4.8 W	
	Umgebungstemperatur	40 °C	
	Max. Verlustleistung	5.9 W	
	Umgebungstemperatur	20 °C	
	Max. Verlustleistung	8.25 W	

Bauteileigenschaften

Farbe Rastfuß	schwarz	Aussparung im Rastfußbereich als Vorbereitung für	Micro-SIM Karte (3FF)
Anzahl Anschlussebenen max.	3		

Bauform - IN-Anforderungen

Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm	Leiterplattenstärke	1.6 mm
Toleranz der Leiterplattenstärke	±0,15 mm		

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Kundenspezifische Beschriftung möglich	Ja	Kundenspezifischer Bestellprozess	Siehe Anleitung unter "Downloads"
Alternative Farben	Mehr auf Anfrage	Bearbeitungsmöglichkeiten	Laserbearbeitung

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Leiterplattenkontur, Sperrzonen, sowie weitere Informationen für das Eindesignen der Leiterplatte sind in der Kategorie Anschlusstechnik bei den zugehörigen Stiftleisten in den Downloads zu finden.		
----------------	---	--	--

Klassifikationen

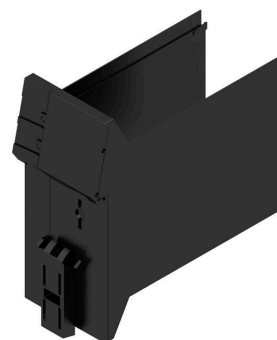
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Zeichnungen

Produktbild



Produktvorteil



Basiselement einschließlich SIM-Ausschnitt

Maßzeichnung

